



RE900-03

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para TSOP I 20, 24 (0,50 mm)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Bajo demanda se ponen a disposición gratuitamente los datos Gerber para la fabricación de la impresión de pasta de soldar
- Tamaño 16,73 x 30,94 mm

Módulo-No.	Typ	Pitch	Pin	Tamaño (mm)
RE900-03	TSOP I	0,500 mm	20, 24	6,00 x 16,00